

特許協力条約

PCT

特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）

International Preliminary Report on Patentability

（法第12条、法施行規則第56条）
〔PCT36条及びPCT規則70〕

(Chapter II of the PCT)

出願人又は代理人 の書類記号 JHTK-100-PCT	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP2005/001486	国際出願日 (日.月.年) 02.02.2005	優先日 (日.月.年) 06.02.2004
国際特許分類 (IPC) Int.Cl. G06K19/07(2006.01), B42D15/10(2006.01), G06K19/07(2006.01), C09J9/02(2006.01), C09J201/00(2006.01)		
出願人 (氏名又は名称) 日立化成工業株式会社		

1. この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。 法施行規則第57条（PCT36条）の規定に従い送付する。	
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。	
3. この報告には次の附属物件も添付されている。 a. <input type="checkbox"/> 附属書類は全部で ページである。 <input type="checkbox"/> 補正されて、この報告の基礎とされた及び／又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び／又は図面の用紙（PCT規則70.16及び実施細則第607号参照） <input type="checkbox"/> 第I欄4.及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙 b. <input type="checkbox"/> 電子媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。 配列表に関する補充欄に示すように、電子形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。 (実施細則第802号参照)	
4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。 <input checked="" type="checkbox"/> 第I欄 国際予備審査報告の基礎 <input type="checkbox"/> 第II欄 優先権 <input type="checkbox"/> 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 <input type="checkbox"/> 第IV欄 発明の単一性の欠如 <input checked="" type="checkbox"/> 第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 <input type="checkbox"/> 第VI欄 ある種の引用文献 <input type="checkbox"/> 第VII欄 国際出願の不備 <input type="checkbox"/> 第VIII欄 国際出願に対する意見	

国際予備審査の請求書を受理した日 05.09.2005	国際予備審査報告を作成した日 24.05.2006	
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 村田 充裕	5N 3563
	電話番号 03-3581-1101 内線 3586	

第 I 欄 報告の基礎

1. 言語に関し、この予備審査報告は以下のものを基礎とした。

- ☒ 出願時の言語による国際出願
- ☐ 出願時の言語から次の目的のための言語である _____ 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文
- ☐ 国際調査 (PCT 規則 12.3(a) 及び 23.1(b))
- ☐ 国際公開 (PCT 規則 12.4(a))
- ☐ 国際予備審査 (PCT 規則 55.2(a) 又は 55.3(a))

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条 (PCT 14条) の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

☒ 出願時の国際出願書類☐ 明細書

第 _____ ページ、出願時に提出されたもの

第 _____ ページ*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

第 _____ ページ*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 請求の範囲

第 _____ 項、出願時に提出されたもの

第 _____ 項*、PCT 19 条の規定に基づき補正されたもの

第 _____ 項*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

第 _____ 項*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 図面

第 _____ ページ/図、出願時に提出されたもの

第 _____ ページ/図*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

第 _____ ページ/図*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3. ☐ 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 _____ ページ
- ☐ 請求の範囲 第 _____ 項
- ☐ 図面 第 _____ ページ/図
- ☐ 配列表 (具体的に記載すること) _____
- ☐ 配列表に関連するテーブル (具体的に記載すること) _____

4. ☐ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT 規則 70.2(c))

- ☐ 明細書 第 _____ ページ
- ☐ 請求の範囲 第 _____ 項
- ☐ 図面 第 _____ ページ/図
- ☐ 配列表 (具体的に記載すること) _____
- ☐ 配列表に関連するテーブル (具体的に記載すること) _____

* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1 - 9	有
	請求の範囲		無
進歩性 (IS)	請求の範囲		有
	請求の範囲	1 - 9	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1 - 9	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

国際調査報告書で引用された文献

- 文献1: JP 2001-237276 A (九州日本電気株式会社)
2001.08.31, 全文, 全図 (ファミリーなし)
- 文献2: JP 2002-164392 A (トッパン・フォームズ株式会社)
2002.06.07, 全文, 全図 (ファミリーなし)
- 文献3: JP 2001-217380 A (株式会社日立製作所)
2001.08.10, 全文, 全図
& US 2001/0012645 A1
- 文献4: JP 2003-228698 A (王子製紙株式会社)
2003.08.15, 全文 (ファミリーなし)
- 文献5: JP 2003-196631 A (トッパン・フォームズ株式会社)
2003.07.11, 全文, 全図 (ファミリーなし)
- 文献6: JP 2003-076969 A (王子製紙株式会社)
2003.03.14, 全文, 全図 (ファミリーなし)

新たに引用した文献

- 文献7: JP 2003-108961 A (株式会社日立製作所)
2003.04.11, 全文, 全図
& US 2003/0063002 A1

(1) 請求の範囲1について: 文献1、7

文献1には、IC素子(半導体素子)の半導体素子表面側に形成された電極(端子)と第1の回路層(アンテナパターン)とが電氣的に接続され、前記IC素子(半導体素子)の裏面に形成された端子と第2の回路層(接地用の金属板)とが電氣的に接続されてなるRFID(電子装置)が記載されている。

ただし文献1に記載された発明においては、前記IC素子(半導体素子)の裏面側は、リードレス電極として形成された端子を介して、第2の回路層(接地用の金属板)とが電氣的に接続されている。

補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V 欄の続き

しかしながら、文献7には、IC素子（半導体チップ）の裏面が一方の電極を構成していて、銀ペーストにより回路層に直接接続してなるRFID（電子タグ）が記載されている。（段落【0025】、図8参照。）

以上を鑑みると、文献1に記載された発明において、文献7に記載された発明を適用することにより、請求の範囲1に係る発明を構成することには、格別の困難性は認められないので、請求の範囲1に係る発明は、進歩性を有しない。

（2）請求の範囲2、4について：文献1～4、7

文献2～4のいずれにも、IC素子と回路層（アンテナパターン）とを異方導電性接着剤で接続することが記載されており、従って、IC素子の裏面側と回路層との電氣的接続のために異方導電性接着剤を用いることにより、請求の範囲2、4に係る発明を構成することには、格別の困難性は認められないので、請求の範囲2、4に係る発明は、進歩性を有しない。

（3）請求の範囲3、5について：文献1～4、7

文献2、3には、IC素子と回路層（アンテナパターン）との接続のための異方導電性接着剤として、それぞれ熱硬化性樹脂を用いること、および導電粒子が混入された接着樹脂を用いることが記載されており、従って、IC素子の裏面側と回路層との電氣的接続のために、導電粒子が混入された熱硬化性樹脂よりなる異方導電性接着剤を用いることにより、請求の範囲3、5に係る発明を構成することには、格別の困難性は認められないので、請求の範囲3、5に係る発明は、進歩性を有しない。

（4）請求の範囲6について：文献1～4、7

文献3には、導電粒子が混入された接着樹脂によってIC素子が封止されている構成（図7）が記載されており、従って、請求の範囲6に係る発明を構成することには、格別の困難性は認められないので、請求の範囲6に係る発明は、進歩性を有しない。

（5）請求の範囲7について：文献1～4、7

文献4には、回路層（アンテナ）を銅やアルミニウムで形成することが記載されており、従って、請求の範囲7に係る発明を構成することには、格別の困難性は認められないので、請求の範囲7に係る発明は、進歩性を有しない。

（6）請求の範囲8、9について：文献1～4、7

文献4には、ポリエチレンテレフタート等の樹脂や紙よりなるベース基材が記載されており、従って、請求の範囲8、9に係る発明を構成することには、格別の困難性は認められないので、請求の範囲8、9に係る発明は、進歩性を有しない。